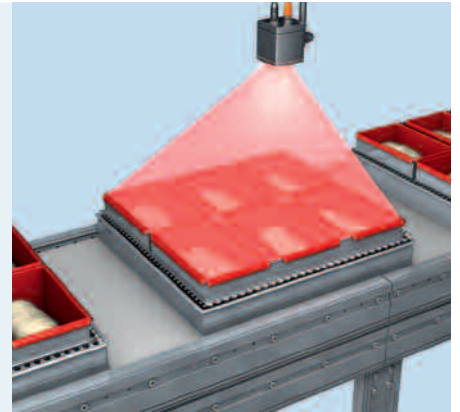




适用于分段容器的3D容积控制



3D传感器



减少浪费和停机时间

不受污染、颜色和涂层的影响

**直观示教，并提供各种形状、
设置和格式的选择**

易于逐步设置参数

**可以分别检测容器的空态和填充
过满情况**

质量控制不受外部光线影响



3D容积控制的优势

系统可以用于检查填充生面团或糊剂等粘性介质容器的均匀情况。以检测双层面团为例。面包自动化生产在同时填充几个烤罐（罐头盒）期间容易出错。未装满的罐头会影响效率。另一方面，填充过满的罐头会降低质量，加剧装置的污染情况，甚至增加火灾风险。

应用广泛

该应用是众多不同制造工艺的最佳选择。它可以用于食品加工（生产面包、奶酪、意大利面食和肉制品），也可以用于制造基于橡胶、乳脂或蜡等的消费品。3D容积控制有助于减少浪费和停机时间，并节省费用。



传感器样式	材料 正面窗格/LED窗口	外壳防护等级 / 防护等级	孔径角 [°]	最大视场尺寸 [m]	订货号
-------	------------------	---------------	------------	---------------	-----

PMD 3D传感器·O3D类型·M12插头·外壳材质：铝

PMD 3D ToF芯片	大猩猩玻璃/聚酰胺	IP 65, IP 67 / III	40 x 30	2.61 x 3.47	O3D300
PMD 3D ToF芯片	大猩猩玻璃/聚酰胺	IP 65, IP 67 / III	60 x 45	3.75 x 5.00	O3D302
PMD 3D ToF芯片	大猩猩玻璃/聚酰胺	IP 65, IP 67 / III	70 x 51	4.00 x 5.50	O3D304

PMD 3D传感器·O3D类型·M12插头·外壳材质：不锈钢

PMD 3D ToF芯片	PMMA/聚酰胺	IP 65, IP 67, IP 69K/II	40 x 30	2.61 x 3.47	O3D310
PMD 3D ToF芯片	PMMA/聚酰胺	IP 65, IP 67, IP 69K/II	60 x 45	3.75 x 5.00	O3D312
PMD 3D ToF芯片	PMMA/聚酰胺	IP 65, IP 67, IP 69K/II	70 x 51	4.00 x 5.50	O3D314

技术参数容积控制

工作距离	[m]	0.3...5
最大处理单元规模		64个物体
物体最小尺寸	[mm]	
物体速度: 0...0.2 m/s		25
物体速度: > 0.2 m/s		45
采样率 / 开关频率	[Hz]	
通过使用位置跟踪功能, 降低图像重复频率		10

更多技术数据

工作电压	[V DC]	20.4...28.8
电流消耗	[mA]	< 2400峰值电流脉冲; 一般平均值 420
额定电流 (每个开关输出)	[mA]	100
短路保护, 脉冲		·
过载保护		·
环境温度	[°C]	-10...50
实际芯片分辨率		25,000 / 100,000
分辨率结果		176 x 132像素
功能显示器	LED	2 x 黄色, 2 x 绿色
照明		850 nm, 红外
抗外来光干扰	[klx]	8 (可达100 klx, 测量精度 和可重复性下降)
触发器		外部; 根据IEC 61131-2 标准第3类为24 V PNP/NPN
开关输入		2 (可配置); 根据IEC 61131-2 标准第3类为24 V PNP/NPN
开关输出数字		3 (可配置); 根据IEC 61131-2 标准为24 V PNP/NPN
开关输出模拟		1 (可配置为电流输出 4...20 mA 或电压输出0...10 V)
参数设置接口以太网		10 Base-T / 100 Base-TX
参数设置选项		通过PC/ 笔记本电脑
尺寸(H、W、D)	[mm]	72 x 67.1 x 95

附件

设计	说明	订货号
----	----	-----

安装附件

	适用于O3D的安装套件	E3D301
	耗散器	E3D302
	双冷却元件	E3D304
	导热体	E3D303

连接技术

	以太网, 交叉插线电缆, 2 m, PVC电缆, M12 / RJ45	E11898
	以太网, 跨接电缆, 2 m, PVC电缆, M12 / M12	E21138
	插座, M12, 2 m, 黑色, PUR电缆, 8针	E11950